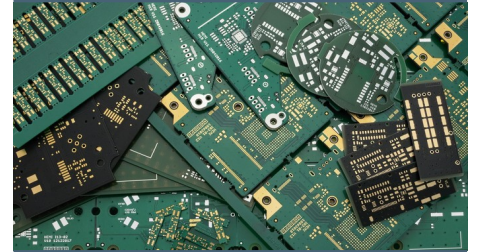


## HEMI fertigt Ihre Baugruppen professionell und zuverlässig. Wenn es sein muss auch mal Express!

Wir haben uns auf kleine Mengen bis ca. 500 Stk/Los spezialisiert (High-Mix, Low Volume). Prototypen und Nullserien (ab 1 Stk) werden grundsätzlich auf der gleichen Linie in Industriequalität gefahren, Zeiten können daher nach Priorität variieren. Bitte fragen Sie an!

### Leiterplatten:

- ✓ Einzelstücke oder Nutzen bis zu 400 x 300 mm<sup>2</sup>
- ✓ Ein- und zweilagig, Multilayer bis 36 Lagen
- ✓ Starre Leiterplatten, Flex und Starr-Flex
- ✓ Dicken ab 200 µm bis 6,00 mm (starr), ab 30 µm bis 250 µm (flex)
- ✓ Kleinste Kontur 85 µm, Standard ist 100 µm
- ✓ Alle geforderten Oberflächen (HASL bis ENIG Gold)
- ✓ Bohrungen ab 0,20 mm (0,10 mm gelasert), Standard 0,3 mm
- ✓ Stopplack und Bestückdruck in vielen Farben
- ✓ Immer mit e-Test, mehr Optionen verfügbar
- ✓ Fertigungszeit ab 24h (zzgl. Versand)



### Bestückung:

- ✓ Ein- und zweiseitige Bestückung
- ✓ SMD ab Größe 01005
- ✓ Standard ist 0402, 0603 und 0805
- ✓ Größte Teile: 80 mm x 33 mm
- ✓ BGA und QFN (ab 0,3 mm Pitch)
- ✓ Asymmetrische Teile
- ✓ Zuführung über Gurt/Reel, Stangen oder Trays
- ✓ Dispenser für Kleben integriert
- ✓ Prozess komplett über Vision-System kontrolliert



### Löten:

- ✓ Immer mit No-Clean Lötpaste
- ✓ Ausschließlich Blei-Frei (RoHS)
- ✓ Dampfphasenlöten für höchste Qualität



### Materialbeschaffung:

- ✓ Standardbauteile (R/C) sind auf Lager
- ✓ Viele übliche Bauteile verfügbar
- ✓ Projektspezifische Teile werden pro Auftrag/Projekt beschafft
- ✓ Beschaffung über alle Distributoren (weltweit)

### Konfektionierung/Montage:

- ✓ Wir montieren Ihre Baugruppe auch komplett
- ✓ Diverse Anbauteile nach Zeichnung
- ✓ Alle Kabelkonfektionierung
- ✓ Gehäuseeinbauten, auch inkl. Dekorfolien und Zubehör
- ✓ Verpackung nach Ihren Vorgaben



### Kontakt:

Für Ihre Anfrage füllen Sie einfach beiliegende Liste möglichst vollständig (digital) aus. Mit Hilfe dieser Daten und Ihren beigefügten CAD-Dateien können wir Ihnen kurzfristig ein Angebot unterbreiten. Dazu alles per Mail an: [auftrag@hemi.de](mailto:auftrag@hemi.de).

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen: Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Durch unsere eigene Hard- und Softwareentwicklung können wir Sie auch gerne im Vorfeld auf eine optimierte Fertigbarkeit (Design to Manufacturing) hin unterstützen oder auch Ihren Serienfertiger für Sie kompetent betreuen. Sollten Sie die Überarbeitung einer bestehenden oder direkt eine neue Baugruppe benötigen, können wir Ihnen ebenso gerne helfen.



## Leiterplatten- und Bestückungsanfrage

Firma:	Ansprechpartner:	Kontakt:	Datum:
Projekt:	Baugruppe:	Version:	Rev.:
Artikel-Nr.:	Beschreibung:		
<b>Leiterplatte:</b>			
Ausführung:			
Basismaterial:	Größe X [mm]:	Größe Y [mm]:	Enddicke [mm]: mm
Lagenaufbau: bei Multilayer Aufbau/Stacking:			
Oberfläche:	Stopplack:	Bestückdruck:	auf <input type="checkbox"/> TOP <input type="checkbox"/> BOT
Kupferdistanzen (Leiterbahnbreite und -abstand):		Kleinste Bohrungen:	
Kupferdicke Außenlagen:		Kupferdicke Innenlagen:	
Kontur:	Nutzensetzung:	Anweisung:	
Daten:	Auszüge:	[*] = Standard ohne Aufpreis	
Anforderungen: <input type="checkbox"/> e-Test 100% [*] <input type="checkbox"/> Impedanzkontrolle: Koordinate Teststrip [mm]: / mit Ohm <input type="checkbox"/> diff.			
<input type="checkbox"/> Testreport (Basismaterial, Abmessungen, Kupfer, Vias, Lötbarkeit) <input type="checkbox"/> UL 94 <input type="checkbox"/> UL 796 <input type="checkbox"/> Schliffbild			
Optionen: <input type="checkbox"/> Goldzungen <input type="checkbox"/> gefaste Kante <input type="checkbox"/> Z-Fräisungen <input type="checkbox"/> Einpresstechnik <input type="checkbox"/> Kantenmetallisierung <input type="checkbox"/> mit Datecode			
Extras Durchkontaktierungen: <input type="checkbox"/> gedeckelt <input type="checkbox"/> gefüllt (im Pad oder BGA) <input type="checkbox"/> vergraben (buried) <input type="checkbox"/> blind <input type="checkbox"/> micro (Laser)			
<b>Bestückung:</b>			
Ausführung:	Lage Nullpunkt im Layout:	Anzahl Stücklisten-/Rüst-Positionen [Zeilen]:	
TOP-Seite: Komponenten SMD [Stk]	Komponenten THT [Stk]	Komponenten Mechanik [Stk]	
BOT-Seite: Komponenten SMD [Stk]	Komponenten THT [Stk]	Komponenten Mechanik [Stk]	
Beschaffung: Sonderkonditionen bei/für			<input type="checkbox"/> Beistellung
Format Stückliste:		Format Pick&Place-Daten:	
Checkpunkte Stückliste: <input type="checkbox"/> Bezeichner vollständig <input type="checkbox"/> Gehäuse definiert <input type="checkbox"/> Toleranzen angegeben <input type="checkbox"/> Dielektrikum angegeben			
<input type="checkbox"/> Spannungen angegeben <input type="checkbox"/> Hersteller spezifiziert <input type="checkbox"/> Bauteile IPC-konform angelegt (Drehrichtung)			
Passermarken: <input type="checkbox"/> gesetzt bei Koordinate 1 [mm] / Koord. 2 [mm] / Koord. 3 [mm] /			
Bad-Check (Nutzen): <input type="checkbox"/> bei Koordinate [mm] / Bad-Mark (Leiterplatte): <input type="checkbox"/> bei Koordinate [mm] /			
<b>Nacharbeit/Montage/Veredelung:</b>			
Etikettierung:		Koordinate [mm]: /	Vorgabe:
Programmierung:		Tool+Adapter:	<input type="checkbox"/> Beistellung, Datei:
Prüfung:		Anweisung:	ggf. Prüfvorrichtung:
Kabelkonfektionierung:			
Verguss/Beschichtung: Material		Anweisung:	
Mechanik: <input type="checkbox"/> Schrauben <input type="checkbox"/> Kühlkörper <input type="checkbox"/> Bolzen <input type="checkbox"/> Tastkappen <input type="checkbox"/> Stecker <input type="checkbox"/> Display andere:			
Gehäusemontage: Artikel		<input type="checkbox"/> mit Bearbeitung Anweisung/Zeichnung:	
Dekorfolie/Etikette: Zeichnung		Positionierung:	Serialisierung:
Verpackung:		Stückelung [Stk]	in/auf: in/auf:
<b>Kalkulationsgrundlagen:</b>			
Gew. Menge/Losgröße [Stk]		Mengentreue:	Gew. Lieferzeit [AT] Zielpreis [EUR netto]
Termine: Angebot bis:		Entscheidung bis:	